

# 全国半导体设备和材料标准化技术委员会

## 封装分技术委员会

设材标〔2024〕6号

### 关于《电子封装用导热绝缘垫片规范》等2项行业标准 (征求意见稿)征求意见的通知

各有关单位:

根据工业和信息化部电子行业标准制订计划安排,《电子封装用导热绝缘垫片规范》(项目计划编号:2024-0896T-SJ)《微波组件用焊锡膏性能测试及应用验证方法》(项目计划编号:2024-0897T-SJ)等2项行业标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会封装分技术委员会(SAC/TC203/SC3)组织执行,由工业和信息化部电子第五研究所牵头起草。

经过前期调研、资料收集、标准起草、讨论等工作,目前标准编制组已完成上述标准的征求意见稿和编制说明(详见附件1),请各单位组织有关人员认真研究,并将意见(填写附件2“意见反馈表”)于2025年1月20日前发送至标准编制组,同时抄送标委会秘书处。

联系方式:

中国电子技术标准化研究院(标委会秘书处)

赵俊莎 010-64102276 zhaojis@cesi.cn

工业和信息化部电子第五研究所（标准编制组）

张莹洁 18620760206 zhangyingjie@ceprei.com

附件：

1. 标准征求意见稿和编制说明
2. 意见反馈表

全国半导体设备和材料标准化技术委员会  
封装分技术委员会  
封装分技术委员会  
业务专用  
2024年12月19日